

先端パッケージ用液状封止材の供試開始のお知らせ

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鍛冶屋 伸一）は、AI 技術の進展に伴い、大型化・複雑化が進む半導体パッケージに対応するため、低反り・高信頼性の液状封止材 EME-L シリーズを開発し、供試を開始したことをお知らせします。

【開発の背景】

生成 AI の急速な普及により、半導体パッケージにはさらなる機能追加、処理速度の向上、および処理容量の増加が求められています。その結果、2.xD/3D 構造やチップレット構造の採用が進み、パッケージサイズ自体の大型化が進んでいます。

このような状況下で、経済生産性を維持しながらパッケージの大型化を実現するためには、液状封止材にもさらなる低反り性・加工性能の向上が求められています。当社は、お客様からの強い要望を受け、これらのニーズに応える液状封止材の開発に着手しました。

【EME-L シリーズの特長】

当社が開発した液状封止材 EME-L シリーズは、固形封止材で長らく培ってきた配合技術や処方技術、さらに電子材料向け液状製品のプロセス技術を応用することで、低反り性能と必要な加工性能の両立を可能にしました。この低反り性能により、封止後のプロセスでの取り扱いが容易になります。



また、モールドアンダーフィルが可能な製品もラインナップしており、アンダーモールドとオーバーモールド（全体封止）の工程を一体化することで、製造プロセスを削減し、効率化を図ることができます（下記図、参照）。これらの特長により、次世代パッケージの高機能化、大型化の実現に寄与します。



【今後の計画】

2026年4月より供試を開始し、2027年の認定採用を目指してまいります。引き続き、お客様との密接な関係を維持しながら、顧客視点に立った材料開発を推進していきます。今後は、世界トップシェアの固形封止材だけでなく液状封止材も合わせて、世の中になかった機能製品を提供することで AI 技術の発展に貢献していきます。

本件についてのお問合せ：

住友ベークライト株式会社 情報通信材料営業本部 lmc@ml.sumibe.co.jp